



中华人民共和国国家标准

GB/T 4588.2—1996
IEC/PQC 90:1990

有金属化孔单双面印制板 分 规 范

Sectional specification: single and double sided
printed boards with plated-through holes

1996-03-22 发布

1996-10-01 实施

国家技术监督局 发布

目 次

1 概述	1
1.1 范围和目的	1
1.2 有关文件	1
2. 总则	1
3 试样	2
3.1 能力批准	2
3.2 质量一致性检验	2
4 有关规范	2
5 印制板性能	2
表 I	3
表 II	6
6 能力试验方案	7
7 质量一致性检验	9
8 试验图形——试验板	11
8.1 试验图形和试验板的应用	12
8.2 综合试验图形(CTP)	12
8.3 综合试验图形(CTP)的多种排列	12

中华人民共和国国家标准

有金属化孔单双面印制板 分 规 范

GB/T 4588.2—1996
IEC/PQC 90:1990

代替 GB 4588.2—84

**Sectional specification: single and double sided
printed boards with plated-through holes**

本标准等同采用国际电工委员会电子元器件质量评定体系标准 IEC/PQC 90《有金属化孔单双面印制板分规范》(1990 年版)。

1 概述

IEC 326-5 是有金属化孔单双面印制板的 IEC 标准,下面的文件包含该 IEC 标准,以及准备按欧洲电工标准化委员会(CENELEC)电子元器件质量评定体系评定的印制板所必需的补充标准,这些标准均与 GB/T 16261—1996《印制板总规范》一致。

1.1 范围和目的

本文件是有金属化孔单双面印制板分规范(SS),当它们准备安装元器件时,不必考虑其制造方法,本规范规定了能力批准试验和质量一致性检验(逐批和周期)所评定的性能及其试验方法。

1.2 有关文件

- IEC 68 基础环境试验程序
- IEC 194 印制电路术语和定义
- IEC 249 印制电路用覆金属箔基材
- IEC 321 印制板安装用元器件的设计和使用指南
- IEC 326-2 印制板试验方法
- IEC 326-3 印制板的设计和使用
- GB/T 16261—1996 印制板总规范
- GB/T 4588.1—1996 无金属化孔单双面印制板分规范

2 总则

本分规范(SS)适用于有金属化孔单双面印制板,亦是制定下列详细规范的基础。

——能力详细规范(CapDS) 它适用于 IEC 249-2 规定的专用材料和能力批准程序。

必要时,每种材料应有一个 CapDS。

能力详细规范(CapDS)可以由国际或国家机构或制造厂制定。

——用户详细规范(CDS) 它适用于用户按照 GB/T 16261—1996 的第 5 章生产印制板。CDS 通常由用户制定并在自己的体系内编号。

GB/T 16261—1996 和 CECC 00114^{1]}的第 III 部分规定了进一步的细节。

采用说明:

1] 新发布的 CECC 00114 第 III 部分代替原 CECC 00107 的第 III 部分。